

試料内部の3次元的な構造を解析！
故障解析や品質確認、内部状態の把握に

こんな方に

トラブルや不具合を
非破壊で検査したい方に

X線による非破壊検査



見学できる機器のモデルコース



実験棟1階
非破壊検査
実験室(2)

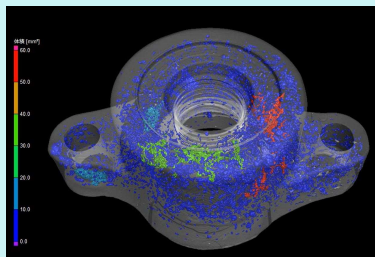
J1-6-1



X線を用いた内部構造撮影装置

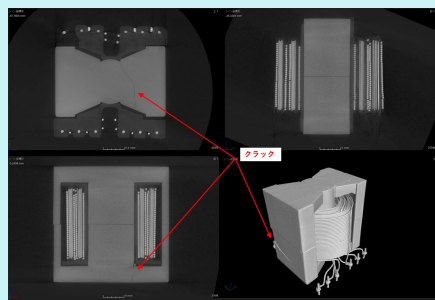
高出力による透過能力と高い分解能を両立したX線CTシステム

- ▶ 試料内部の3次元的な構造を解析することが可能な装置です。
- ▶ 様々な試料の故障解析や品質確認、設計支援等に役立ちます。
- ▶ 対象試料の外形寸法はφ420×H450mm、重量20kgのものまで撮影が可能です。(分解能は撮影条件により異なるが最良で約5μm)



(左)アルミダイカスト内の集体積による色分け表示

(右)コイル内部の欠陥解析



実験棟3階
非破壊検査
実験室

J3-8-2

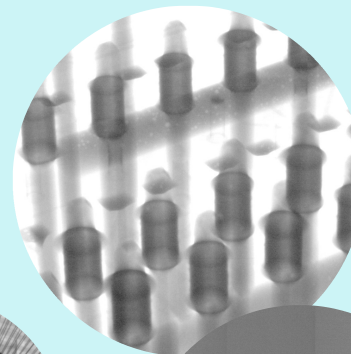


X線透視装置

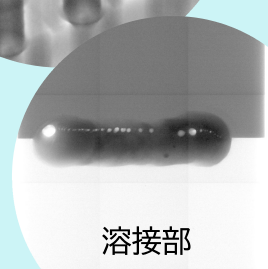
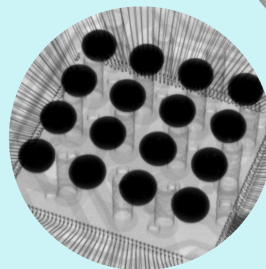
電子基板、電子・機械・プラスチック部品等内部をX線により内部を透視観察

- ▶ 観察対象内部をX線により透視します。
- ▶ 実装基板、電子部品等の様々なサンプルの故障解析や品質確認、内部状態の把握に！
- ▶ 対象試料の外形寸法はW460×D410×H100mm、重さ5kgのものまで撮影が可能です。
- ▶ 主な対象:実装基板、電子部品、機械部品、プラスチック部品等。

(右)スルーホールはんだ上がり



(下)電子基板BGA接合部



溶接部